



第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目: **小芯片到 65 了!**

演讲人: Charles E. Bauer 博士 专务董事 TechLead Corporation

演讲人简介:

Charles E. Bauer 博士担任 TechLead 公司的专务董事，该公司是一家专门从事电子封装、互连和组装行业的技术管理公司，也是波特兰大学全球高管领导力 MBA 课程的主任。Bauer 博士专注于战略技术规划、市场分析和业务发展领域，尤其是在国际舞台上。最近的重点包括强调医疗设备应用，包括传感器和成像系统。

Bauer 博士将植入式、外科手术和诊断医疗设备的应用经验与广泛的设计和制造背景相结合，为现实世界的产品在技术和实际实施之间提出了平衡的观点。他拥有 40 多年的经验，从复杂的互连技术（印刷电路板、混合和 IC 金属化和制造）到复杂的封装（多芯片模块、系统级封装、3D 封装）和组装（芯片贴装、引线键合、倒装芯片等）以及纳米技术在电子制造中的应用，他的出版物超过 250 篇论文、文章和专栏。他在世界各地就技术、商业和市场主题发表演讲，并在多个公司董事会和国际公司、政府和教育机构咨询委员会任职。

作为 IEEE 的高级会员，他仍然活跃于 SMTA、JIEP、ASM 和 IMAPS 欧洲。Bauer 博士曾在 SMTA 和 IMAPS 的董事会任职，并于 2001-2002 年担任 IMAPS 的主席。获得的奖项包括泰克技术创新奖、IMAPS 院士、SMTA 国际领导奖、耶稣会高中名人堂、波特兰大学重要 75 名校友和 SMTA 25 周年杰出人物，作为泛太平洋微电子研讨会的创始人，以及最近获得 SMTA 的创始人奖！